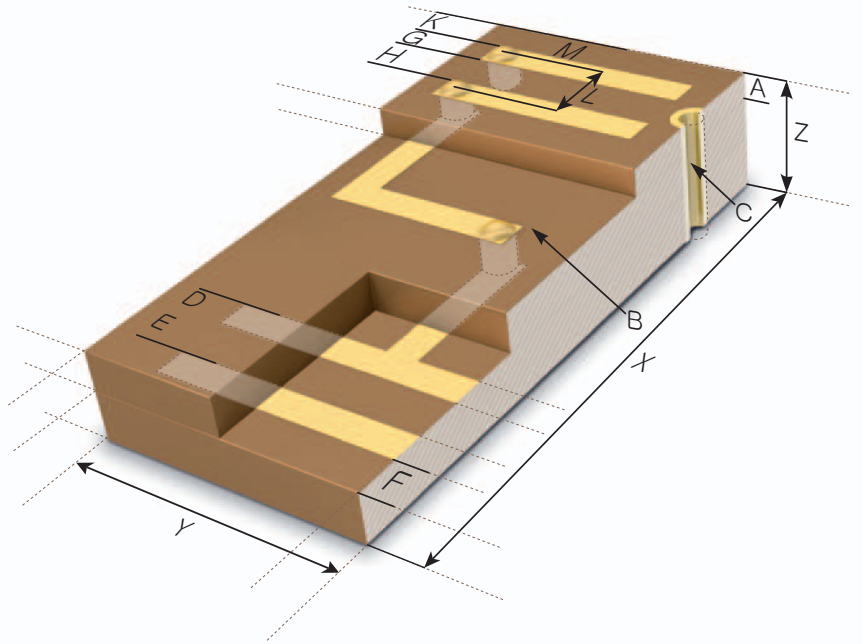


# 고온 동시소성 세라믹 (HTCC) 기판의 설계 규정

사용되는 패키지 (제품)

- 레이저 펌프
- MEMS 애플리케이션
- IR 센서



재료 데이터

구조 파라미터	표시	표준	허용오차	특수	허용오차	
구조 파라미터	길이	X	5 - 25	± 1 % (as fired)	2 - 50	± 0.5 % (as fired)
	폭	Y	5 - 25	± 0.05% (machined)	2 - 50	± 0.03% (machined)
	기판 두께	Z	0.4 - 3	± 3 %	0.2 - 5	± 1.5 %
	층 두께	A	0.12, 0.2, 0.25 0.32, 0.4, 0.5	± 10 %	0.1	± 5 %
	평면도 (as fired)		0.08 / 10 mm		0.05 / 10 mm	
	평면도 (machined)		0.02 / 10 mm		0.005 / 10 mm	
수직 인터커넥트	Filled Via					
	일반 직경	B	0.18		0.1	
	직경 범위		0.15 - 0.3		0.1 - 0.5	
	Via-to-Via 센터라인	L	1			
	Via-to-Edge	M	두께 + via 직경			
	Bore Coated Via					
내부 금속회로	일반 직경 (ID)	C	0.4			
	직경 범위		0.4 - 0.8			
	선 폭 (via 없는 경우)	D	0.08	± 20 %		
	선 간 공간 (via와의 거리)	E	0.08	± 20 %		
	선 폭 (via 있는 경우)		0.25	± 20 %		
표면 금속회로	선 간 공간 (via 근처)		0.2	± 20 %		
	edge로부터의 공간	F	0.7		0.5	
	선 폭 (via 없는 경우)	G	0.1	± 20 %		
	선 간 공간 (via와의 거리)	H	0.1	± 20 %		
	선 폭 (via 있는 경우)		0.3	± 20 %		
선 간 공간 (via 근처)		0.25	± 20 %			
edge로부터의 공간	K	0.4		0		

단위: mm, %

추가 정보 문의처:  
 쇼트 전자부품 패키징 사업부  
 광학 전자 부문  
 Christoph-DornerStresse 29  
 84028 Landshut  
 Germany

전화: +49 (0) 871/826-329  
 팩스: +49 (0) 3641/288-89090  
 Tanja.Wituschek@schott.com  
 www.schott.com/epackaging

**SCHOTT**  
 glass made of ideas

No responsibility can be taken for the accuracy of this information. Despite the fact that all reasonable care was taken in presenting and keeping this information up to date, SCHOTT neither accepts legal responsibility nor guarantees the completeness and accuracy of the information presented here. Date issued: June 2009